

	△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日		△の数	訂 正 記 事	担当	検図	年月日	
△	1	RE-F-09795	中村	山口	04.05.21	△						
△						△						
適 用 規 格												
定 格	使用温度範囲		-55℃ ～ 85℃ (注1)			保存温度範囲		-10℃ ～ 60℃ (注2)				
	電 圧		AC 200 V			使用湿度範囲		40 % ～ 80 %				
	電 流		1 A			保存湿度範囲		40 % ～ 70 % (注2)				
性 能												
	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT			
構 造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。		○	○			
	表示	目視にて確認する。						○	○			
電 気 的 性 能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				15 mΩ以下		○	—			
	低電流、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。				15 mΩ以下		○	—			
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。				1000 MΩ以上		○	—			
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。		○	—			
機 械 的 性 能	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—			
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—			
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。						○	—			
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上		○	—			
	温度サイクル	△	温度 -65→+15→+35→+125→+15→+35℃ 時間 30→10～15 分 → 30→10～15 分 を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○	—		
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 15 mΩ以下		○	—			
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA-38)				② はなはだしい腐食がないこと。		○	—			
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間 はんだごての場合: こて温度 350℃ はんだ付け時間 3 秒以内				性能に影響する樹脂部の溶融が無いこと		○	—			
	はんだ付け性	はんだ温度 245±3℃, 浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95 %以上が新しいはんだでぬれていること。		○	—			
備考						製 図	担 当	検 図	承 認	出 図		
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。												
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。												
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目												
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表			製品名 HIF3 ^{FB} FBA-**-**PA-2.54DS(71)						
旧CL CL		図番 SLC4-083746-21		製品コード CL616				1		1		